

第9回 JEITA 電子材料セミナー—レアアースに関する政策と次世代モータの技術開発動向—

主催：電子部品部 電子材料事業委員会
 開催日：2012年11月30日
 参加者数：約80名

電子材料事業委員会は、電子材料に関する情報の収集や調査、研究、関連諸問題への対応を行い、日本の電子材料／部品業界の健全な発展に貢献することを目的として活動しています。

このような取り組みの一環として、毎年セミナーを開催しており、第9回目となる今回は、自動車や電子機器類に高性能を付与する「レアアース」にスポットを当て、レアアースに関する政策的な対応や、省資

源化に着目したモータの技術開発動向について3名の講師をお招きして紹介しました。

経済産業省からは、日本国内の技術的対応から国際的な取り組み、資源確保戦略について、最新動向と課題を交えながら総合的にご説明いただきました。(株)日立製作所からは、資源対策の観点からモータの技術開発に関する検討課題の提示と、省資源化に着目した今後の開発動向について解説いただきました。(株)本田技術研究所からは、EV・HEV用モータ開発の現状とそのサプライチェーンについて考察していただき、解説・課題提起がなされました。

○開会挨拶

JEITA 電子材料事業委員会 委員長 藤井博行 氏 (日立金属(株) 代表執行役 執行役社長)

○『レアアース問題の最新動向と政策的対応』

経済産業省 製造産業局 非鉄金属課 希有金属室長 井上幹邦 氏

○『資源対策を考慮した高効率モータの検討課題と開発動向』

(株)日立製作所 日立研究所 モータシステム研究部 部長 三上浩幸 氏

○『EV・HEV用モータ開発のトレンドと今後の課題』

(株)本田技術研究所 四輪 R&D センター 第5技術開発室 主任研究員 山本恵一 氏



電子部品部会 / 標準化委員会及び実装部品包装標準化専門委員会 活動報告会

主催者名：電子部品部会 / 標準化委員会
及び標準化政策委員会 / 電子実装
技術委員会 / 実装部品包装標準化
専門委員会

担当部署：電子部品部及び知的基盤部

開催日：2012年12月4日

参加者数：約90名

電子部品部会 / 標準化委員会及び実装部品包装標準化専門委員会では、IEC（国際標準化機関）から発行される文書の審議、JIS 原案、JEITA 規格の作成など、国内外における電子部品及び包装の標準化を行うための実務的な作業を行っており、毎年、活動報告の場として活動報告会を開催しております。

今回は、当業界及びその関連業界の多くの方々を対象に、JEITAにおける標準化活動（電子部品周辺分野）について周知し、ご理解いただくことを目的に第7回目となる標準化報告会を開催しました。

講演内容は、東京大学 / 小川紘一先生による国際標準化と事業戦略についての基調講演、経済産業省担当官による国際標準化の重

要性及び取組についての講話のほか、各標準化専門委員会の活動概要及びトピックス、各 IEC/TC・SC 国内委員会による直近に開催された国際会議の内容も盛り込まれた国際標準化活動状況報告、並びに自動車技術会 / 電子電装部会のリエゾン報告等を行うと共に、平成25年1月から施行される電気二重層キャパシタの国連危険物輸送勧告についての概要説明を行いました。また、実装部品包装の標準化活動報告や実装部品包装材料における静電気発生に関する対策検討や IEC/TC40&TC101 JWG13国際標準化活動の報告が行われるなど、国内外問わず標準化のための幅広い情報を発信できた報告会となりました。

